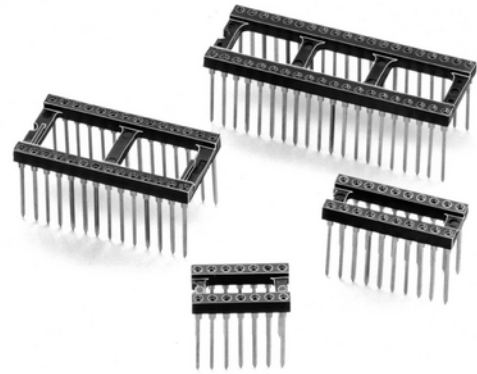


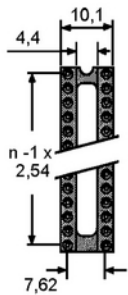
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Hülse: Messing gedreht Feder: 4-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer <i>Sleeve: screw machined brass Clip: 4-Finger-Clip, Beryllium-Copper</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to plating options, over Ni</i>
Lötbarkeit <i>Solderability</i>	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 10mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1kV <sub>RMS</sub>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	100V <sub>RMS</sub> / 150V <sub>DC</sub>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55°C ... +125°C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>

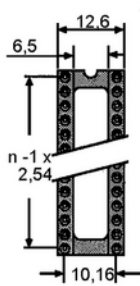


© W+P PRODUCTS

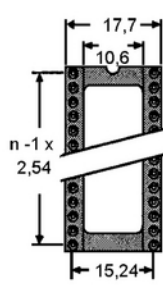
Dip Spacing 3



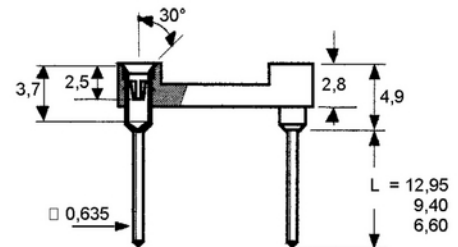
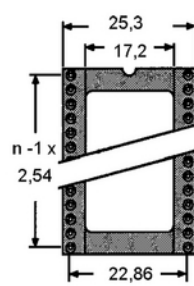
Dip Spacing 4



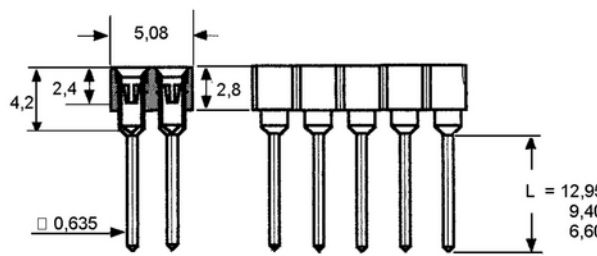
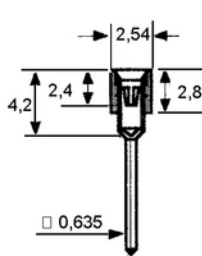
Dip Spacing 6



Dip Spacing 9



IC-Fassung Serie 170  
IC-Socket Series 170



IC-Leiste Serie 184  
IC-Strip Series 184

Series	Contacts*	DIP*	Terminals*	Sleeve Plating*	Clip Plating*
<b>170</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
170 IC-Fassungen IC Sockets	06 08 10 12 14 163 18 20 22 24 28 20 22 24 28 32 10 24 28 32 36 409 42 48 50 52 50 52 64	7,62mm 10,16mm 15,24mm 22,86mm	10 L=6,60mm 20 L=9,40mm 30 L=12,95mm	10 Hülse vergoldet 0,25µm 10µ" gold plated sleeve 50 Hülse verzinkt Tin plated sleeve	10 Feder vergoldet 0,25µm 10µ" gold plated clip 30 Feder vergoldet 0,75µm 30µ" gold plated clip
Series	Contacts*	Rows*	Terminals*	Sleeve Plating*	Clip Plating*
<b>184</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
184 IC-Leisten IC Headers	01-64 Einreihig Single row 02-64 Zweireihig Double row	1 Einreihig Single row 2 Zweireihig Double row	10 L=6,60mm 20 L=9,40mm 30 L=12,95mm	10 Hülse vergoldet 0,25µm 10µ" gold plated sleeve 50 Hülse verzinkt Tin plated sleeve	10 Feder vergoldet 0,25µm 10µ" gold plated clip 30 Feder vergoldet 0,75µm 30µ" gold plated clip

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** - please replace by your specifications.

## Informationen zum Wellen-Lötverfahren Wave Soldering Information

### Empfehlungen für das Wellenlötverfahren Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.  
*Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.*

Empfohlenes Wellenlötprofil:  
*Recommended wave soldering profile:*



## Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

### Reflow-Löttempfehlung Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

